



# (株)フェローテック(6890) 2002/3月期決算説明会

2002年5月28日

<http://www.ferrotec.co.jp/>

本資料は、2002年3月期決算の業績に関する情報の提供を目的としたものであり、本資料は2002年5月22日現在のデータに基づいて作成されております。本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点の当社の判断であり、予告なしに変更されることがあります。



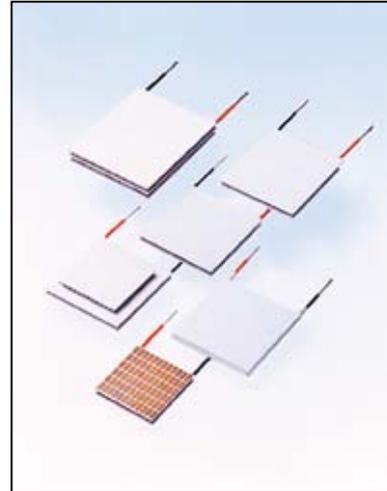
# 主要製品の状況とCMS事業の展開



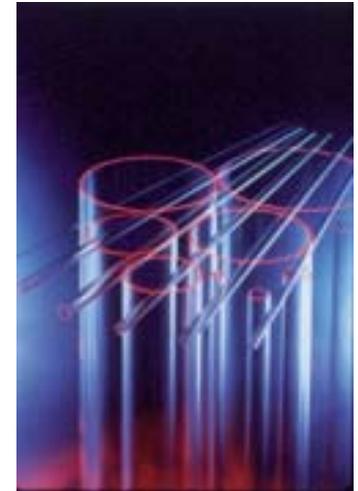
コンピュータシール



真空シール



サーモモジュール

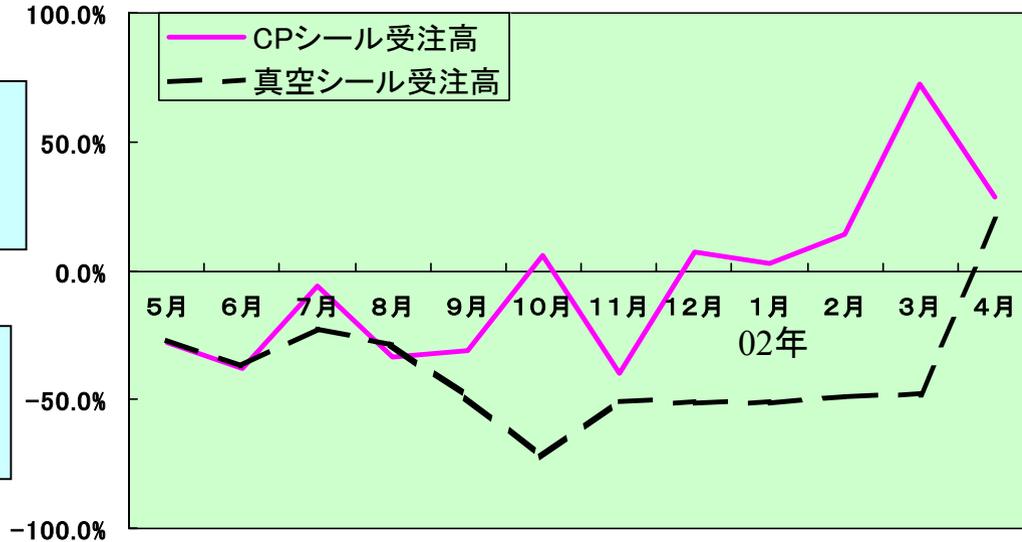


石英製品



# 主要製品の状況(03/3期)

### 前年対比受注推移



**真空シール** ・FPD関連は堅調  
**コンピュータシール** ・後述記載

**石英製品** ・中国への生産移管  
 ・米国への製品販売開始

**サーモモジュール**  
 ・自動車用温調シート向け拡大  
 ・ポリイミド仕様のモジュールの量産開発中





# CMSの状況

## CMS(コントラクト・マニュファクチャリング・サービス)

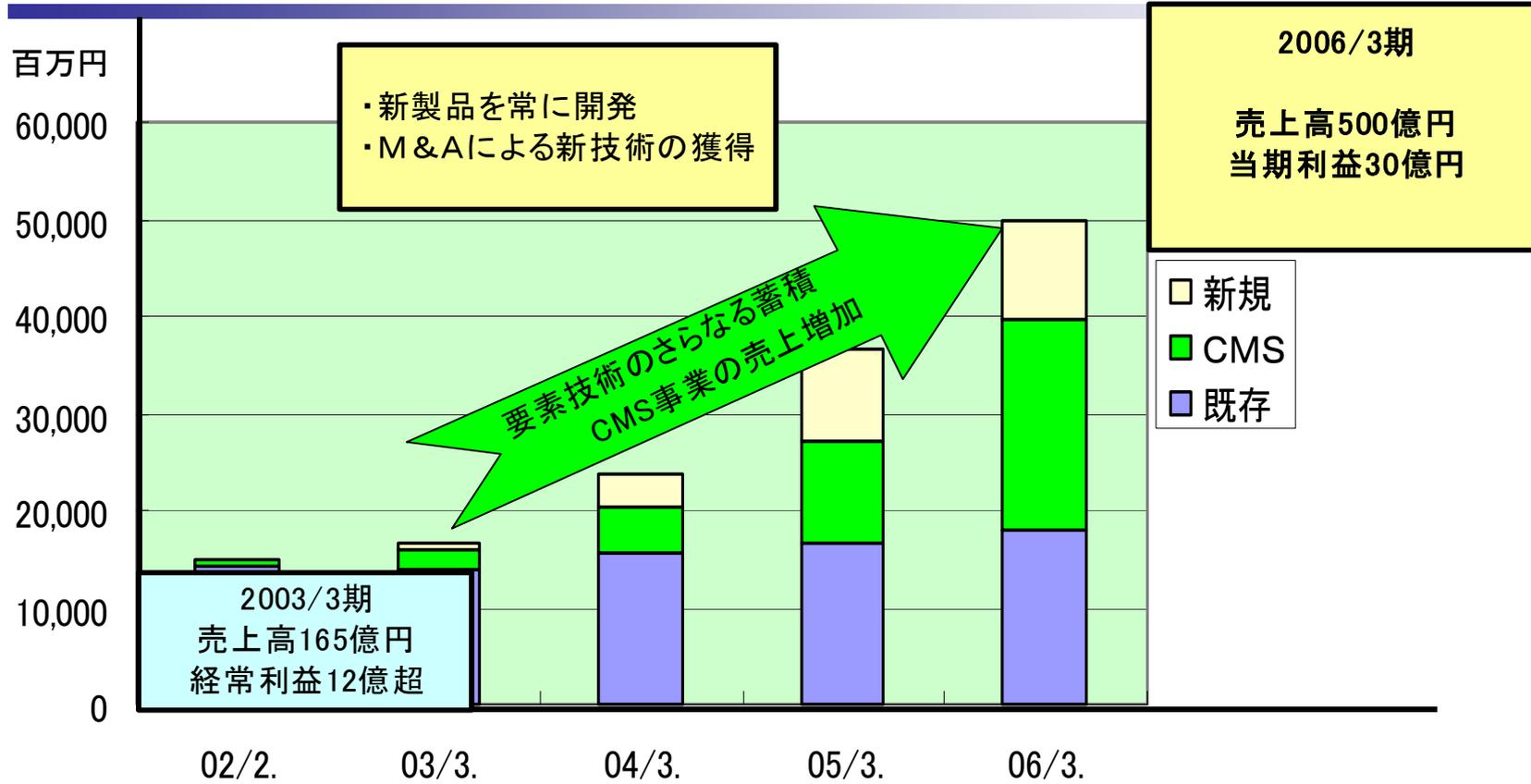
- ・洗浄事業 実働開始  
ULVAC・NEC・SMIC 等
- ・東芝セラミックスのシリコンウェハー受託加工  
月産5万枚から40万枚  
8インチも視野
- ・新規案件の受注と引合い  
米国企業－半導体製造装置分野



上海工場新棟



# 中期目標





# 補足資料

---

IR担当連絡先

フェローテック総務部 広報課

電話 3281-8186 FAX 3281-8160

<http://www.ferrotec.co.jp/>

本資料の原本は下記サイトでご覧になれます(5月29日より)

【IR Street】 <http://www.irstreet.com/>



# 会社概要

---

- 商号： (株)フェローテック (英訳名)Ferrotec Corporation
- 設立： 1980年9月 (店頭登録 1996年10月)
- 役員： 代表取締役 山村 章  
取締役 賀 賢漢、福井 徹、神野公行(社外)、椿 勲(社外)、鈴木史郎(社外)、  
常勤監査役 松井宏之 監査役 中元紘一郎、小林武彦、兼本雅文
- 資本金： 58億22百万円 (期末発行済株式数:17,248,325株)
- 大株主： 三井物産16.23%、小松製作所10.55%、クボタ6.96%  
ザ チェースマンハッタンバンク(ロンドン)5.66%、山村章5.53%



# 連結会社情報

## 連結子会社8社

### 中国

杭州大和熱磁電子有限公司 (自社製品の外、CMS事業の生産拠点)

上海申和熱磁電子有限公司 (CMSのシリコン加工・装置洗浄の拠点)

### 米国・欧州

Ferrotec (USA) Corporation (ヨーロッパに4箇所の子会社を有する)

### アジア

FERROTEC CORPORATION SINGAPORE (HDD関連の研究開発拠点)

### 日本

(株)フェローテック精密 (真空シールの国内生産拠点)

(株)フェローテッククオーツ (石英製品製造販売、国内に3工場保有)

(株)フェローコム (基板実装・セラミックス製品の生産拠点)

(株)テクノシリコン (単結晶シリコン引上と装置の開発・販売・保守)



# 会社沿革

- 1980年: 米国フェローフルイデイクス社の日本販売子会社として設立
- 1983年: 日本国内で磁性流体応用製品の製造を開始
- 1987年: 米国本社より全株式を取得し独立 (MBO)
- 1988年: 国産磁性流体の製造開始
- 1992年: 中国に中国現法設立し、サーモモジュール・コンピュータシールを製造開始
- 1996年: 店頭公開 (IPO)
- 1998年: 石英製造会社GSQ (現フェローテッククオーツ) を子会社化
- 1999年: 元親会社のフェローフルイデイクス (現フェローテックUSA) を友好的TOBで買収
- 2001年: コマツグループとの業務提携 / 米国アメリゴン インコーポレイテッドと業務提携  
株式会社胆沢通信 (現フェローコム) を買収
- 2002年: テクノシリコンを株式交換にて子会社化



# 2002年3月期下半期のトピックス

---

2001/11 上海で洗浄事業を開始

メンテナンス事業の開始

2001/12 ポリイミド仕様のサーモモジュールの開発を発表

2002/2 三井物産、コマツに対する第三者割当増資を実施  
テクノシリコンを株式交換により買収

CMS事業推進のための強力なアライアンス

シリコンウェハー関連事業進出の体制作り

2002/3 東芝セラミック、三井物産と小口径シリコンウェハーの  
加工委託で合意



# 第三者割当増資の概要

**フェローテック**  
増資により約40億円を調達  
調達資金用途  
・中国でのCMS事業関連投資等  
25億円  
・借入金返済  
15億円

第三者割当増資  
2,800,000株

三井物産(株)

第三者割当増資  
1,220,000株

小松製作所(株)

## 実施理由

- ・ CMS事業の投資資金の調達
- ・ 株主資本と有利子負債のバランス
- ・ 安定株主作り

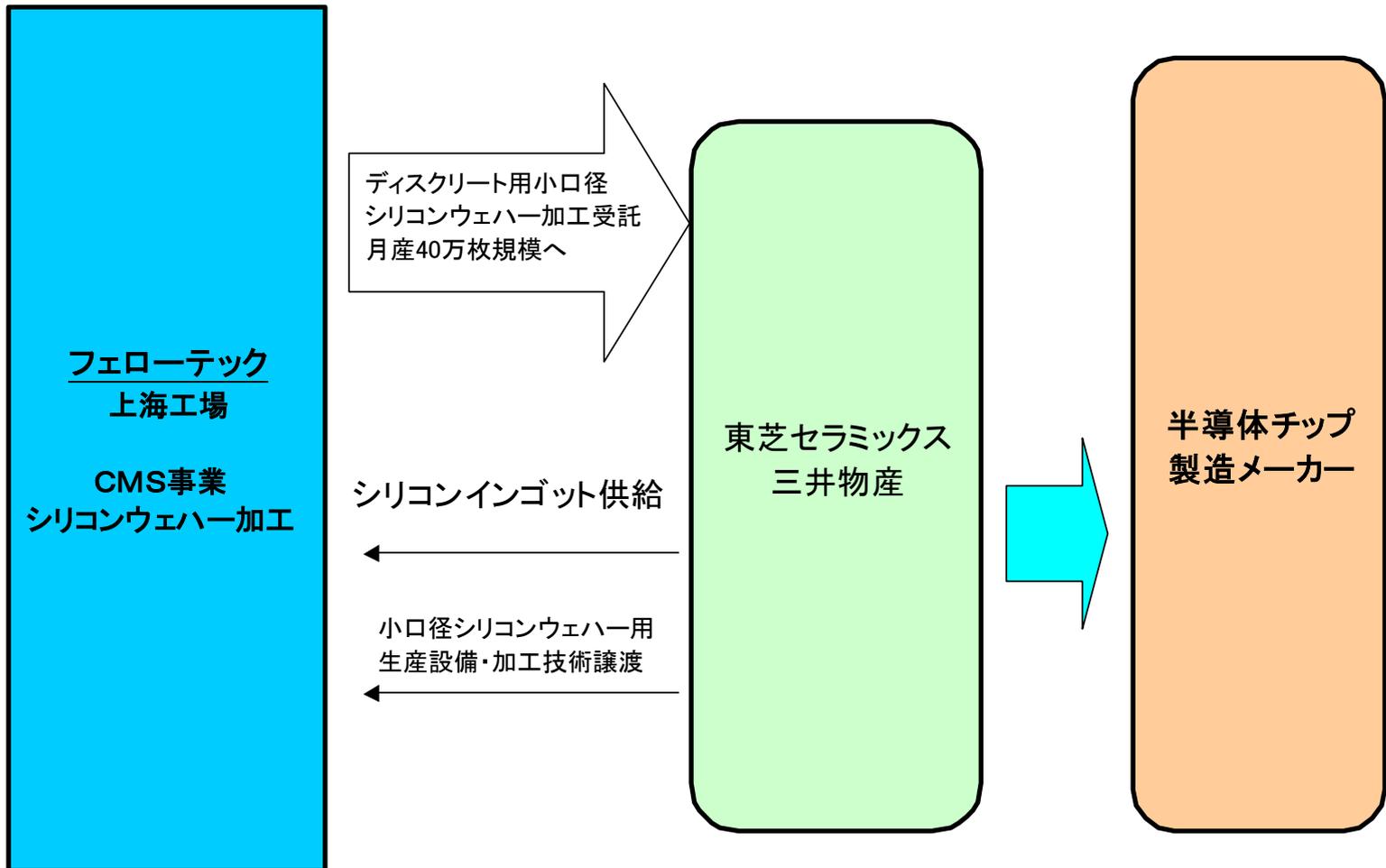
## 提携の効果

- ・ CMS事業でのシナジー(取引先開拓、製品流通)
- ・ CMSを通じた共同事業展開





# シリコンウェハー事業提携の概要





# シリコン事業の展開

## 同事業参入の背景

- ・ 三井物産との提携による中国事業の第一弾
- ・ 当社が保有していた切削、研磨などの技術が応用できる

## 当面の事業内容

- ・ ディスクリット用小口径ウェハー(個別半導体)のスライスから鏡面加工
- ・ 月産5万枚でスタートし、40万枚へ拡大

## 中期的展開

- 小口径(6インチ)で実績を積み、8インチ~12インチへ展開
- ・ 子会社化したテクノシリコンは単結晶インゴット引上技術を保有
- ・ インゴット製造からウェハー加工までの本格的事業へ展開



# 中国への進出

当社は92年から中国に進出以来、

- 部品加工から組立までの一貫した生産技術の蓄積により、CMS事業へ進出する基礎を着実に確立してきた。

92年: 杭州大和熱磁電子有限公司を設立、サーモモジュール・コンピュータシール製造開始

95年: 上海申和熱磁電子有限公司を設立、サーモモジュール原材料の製造

96年: 杭州工場でISO9002を取得 上海にてラッピング機器・ポリッシュ機器の組立開始

98年: 上海にてメッキ加工を開始

杭州にて精密切削加工部品の製造を開始

99年: 杭州大和精密部件有限公司(のちに杭州大和熱磁電子有限公司に統合)

上海工場にてISO9002を取得

00年: 杭州に3番目の工場開所、真空シール、石英素材、サーモモジュールを製造

上海工場でISO14001取得

木工加工機組立を開始

01年: 杭州工場でISO14001取得 上海にて洗淨事業用工場・大型機器組立工場を増築

02年: 中国進出10周年 シリコンウェハー加工受託を開始



# 中国事業の位置付け

## 中国への事業展開の経緯

- ・安価な人件費で日本の技術習得を目標とする人材の確保
- ・精度の高い製品のコスト低減を目的とした生産拠点

## 現在の位置付け

- ・圧倒的なコスト競争力に日本の技術を備えた主力生産拠点
- ・中国参入企業をターゲットにしたマーケット

## 将来の位置付け

- ・技術者などグループの中核となる人材の供給地
- ・現地市場からの資金調達



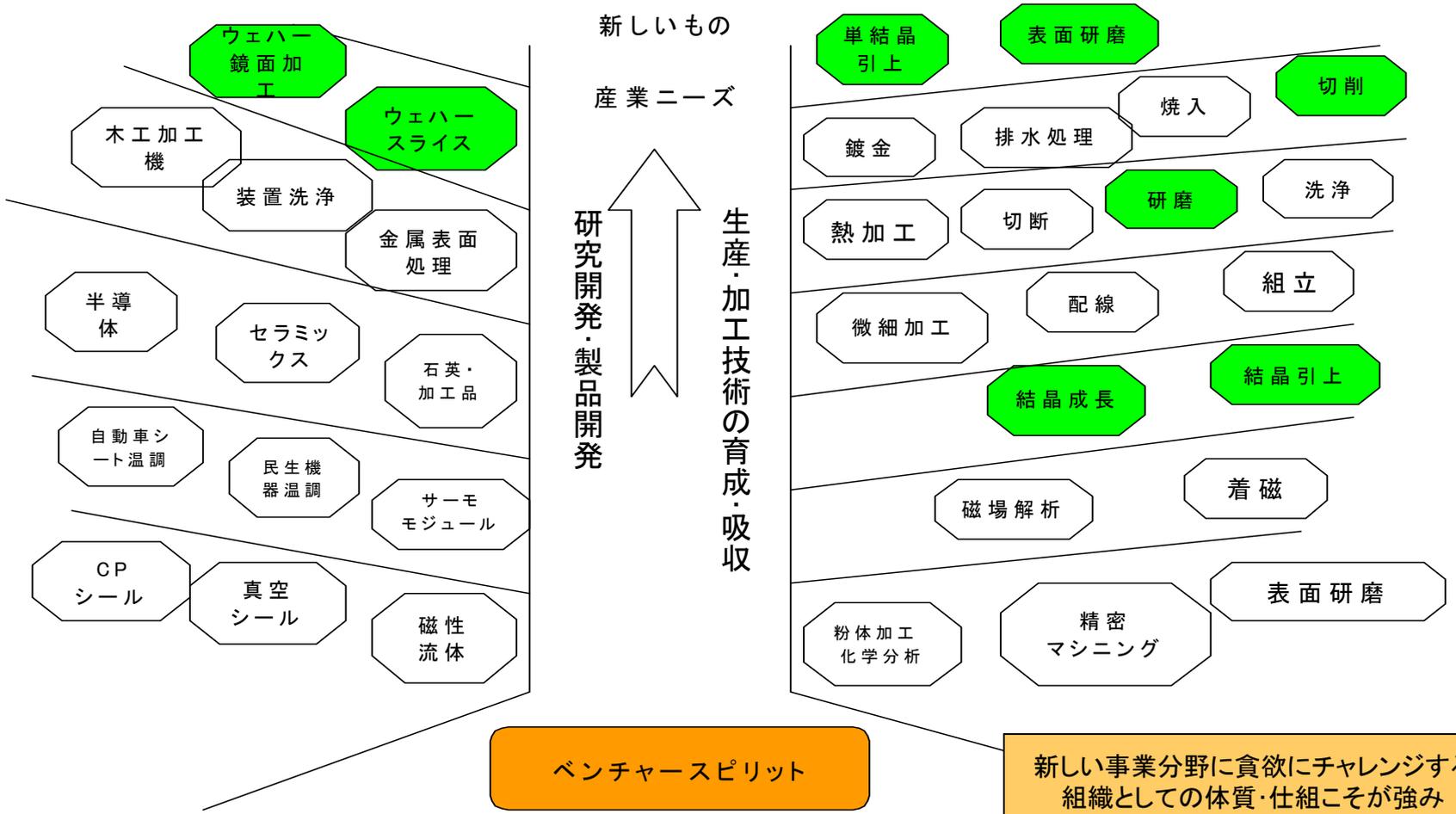
# 成功要因：中国子会社運営の強み

- 現地マネージメント主義
- 従業員の育成  
奨学金制度、社内教育、インセンティブ
- 中国地方政府との協調関係





# フェローテックの進化





# CMS事業の基礎となる技術の集積

CMS市場におけるフェローテックの競争力



加工技術



製品

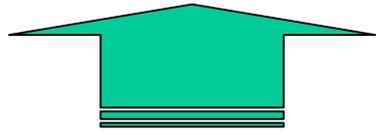




顧客ニーズから  
部品受託生産開始

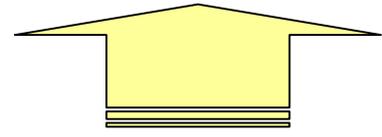
横展開 →

CMS事業の拡大

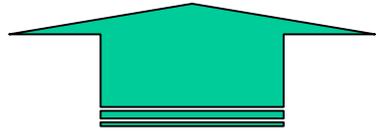


コスト低減目的  
中国移管

シナジー効果  
による競争力

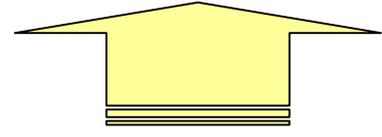


マーケットの取得  
顧客からの要望

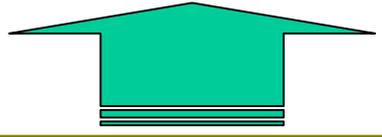


要素技術の集積

横展開 →



技術の組み合わせ



自社製品・コア技術  
CPシール：真空シール  
サーモモジュール

M&Aによる技術取得  
石英・SMT・セラミックス  
単結晶引上



# 2003年3月期業績予想

	2001年連結 3月期 売上	2002年連結 3月期 売上	構成比	2003年連結 3月期 売上	構成比	比較増減	増減比
売上高	16,435	14,761	100.0%	16,500	100.0%	1,739	
CPシール	2,585	2,209	15.0%	2,000	12.1%	▲ 209	-2.8%
真空シール	5,100	3,931	26.6%	3,200	19.4%	▲ 731	-7.2%
サーモモジュール	1,150	893	6.0%	1,100	6.7%	207	0.6%
HDD関連製品	880	731	5.0%	800	4.8%	69	-0.1%
石英製品	3,670	3,036	20.6%	3,800	23.0%	764	2.5%
その他製品	1,547	2,189	14.8%	2,300	13.9%	111	-0.9%
EB-ガン	1,503	1,772	12.0%	1,500	9.1%	▲ 272	-2.9%
CMS事業	(550)	(1,000)	←参考値	1,800	10.9%		
売上原価	9,350	8,721	59.1%	10,350	62.7%	1,629	3.6%
売上総利益	7,085	6,060	41.1%	6,150	37.3%	90	-3.8%
販売管理費	4,420	5,083	34.4%	4,830	29.3%	▲ 253	-5.2%
営業利益	2,665	916	6.2%	1,250	7.6%	334	1.4%
経常利益	2,561	984	6.7%	1,210	7.3%	226	0.7%
税引前利益	2,209	-198	-1.3%		0.0%	198	1.3%
当期純利益	1,644	-357	-2.4%	800	4.8%	1,157	7.3%
EPS	129.31	-26.9		46.38			
ROE	16.6%	-2.7%		5.0%			

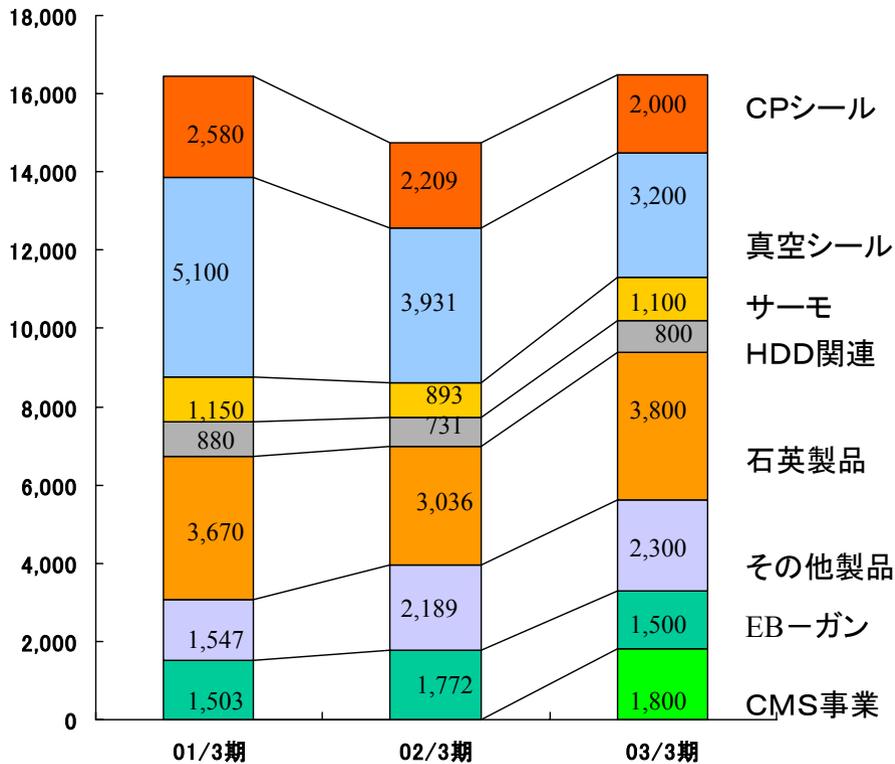
01/3-02/3期のCMS事業数字は、各製品に含まれているため参考値を表示しております。



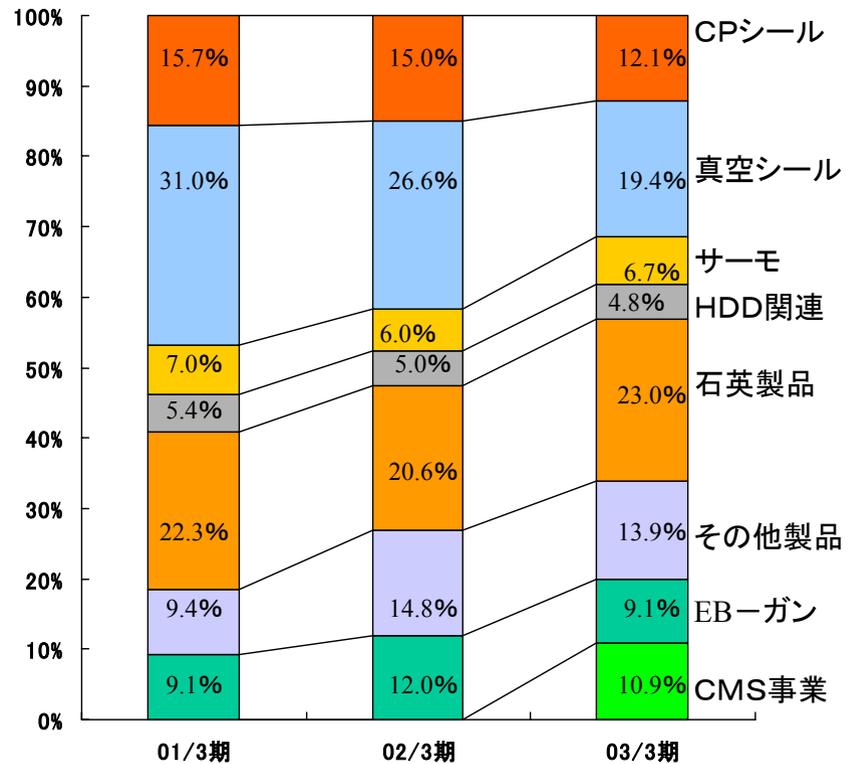
# 製品別売上高推移

## 製品別売上高推移

百万円



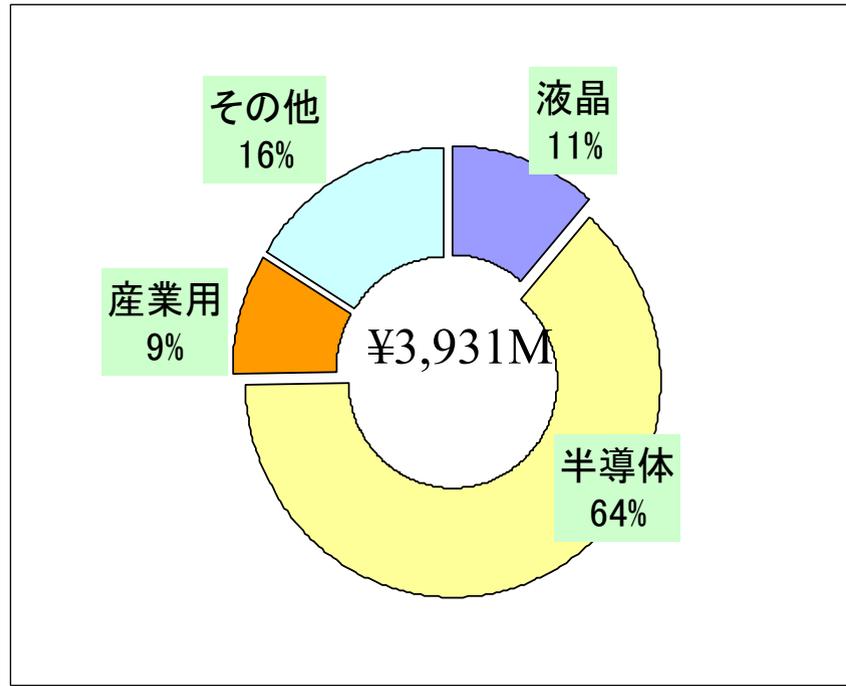
## 製品別売上高シェア推移





# 2002年3月期業績(連結)

## 真空シールの販売先業種



## サーモモジュール販売先業種

